

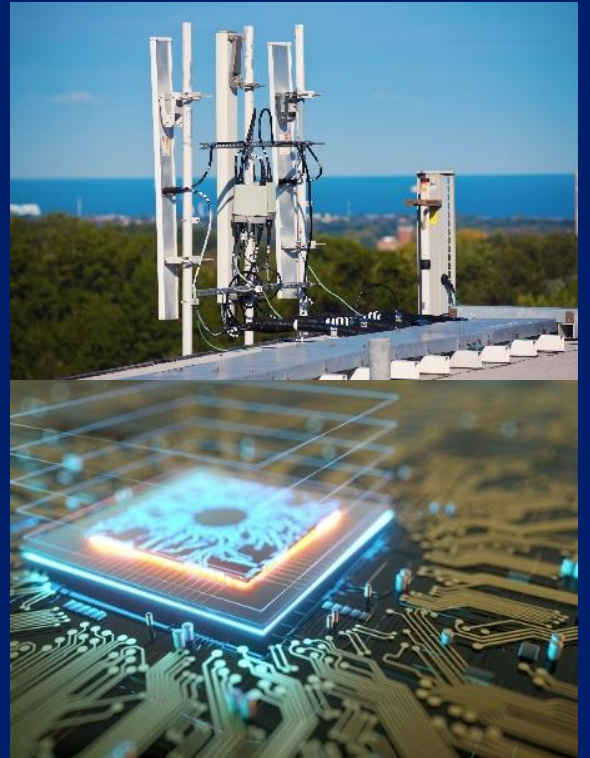
저가형 RF 기판

특장점

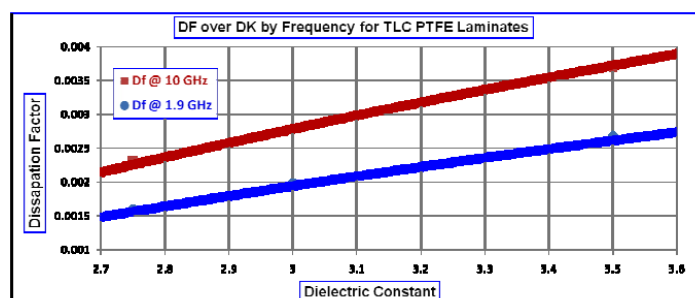
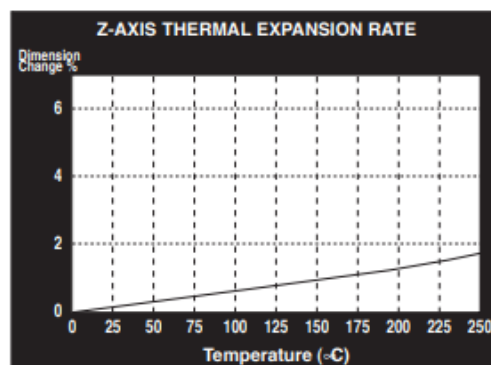
- PCB에서의 우수한 PIM 값 (-160dBc* 미만에서 측정됨)
- 저비용
- 엄격히 제어된 DK 공차
- 낮은 Df
- 우수한 치수 안정성
- 높은 굴곡강도
- UL 94 V-0 등급

적용분야

- LNB
- 전력 증폭기
- PCS/PCN 대형 안테나
- 수동 컴포넌트



TLC-32 라미네이트는 다양한 마이크로파 애플리케이션에 적합한 비용 효율적인 기판을 제공하도록 설계되었습니다. TLC-32 라미네이트는 열경화성 라미네이트보다 우수한 전기적 성능을 제공합니다(예: FR-4, PPO, BT, 폴리아미드 및 시안산염 에스테르). TLC-32의 구조는 또한 우수한 기계적 안정성을 제공합니다. TLC-32 라미네이트는 PTFE/직조 유리섬유 소재에 대한 표준 방법을 사용하여 Shearing, 드릴링, 밀링 및 도금을 할 수 있습니다. 라미네이트는 치수 안정성이 뛰어나며 제조시 수분을 거의 흡수하지 않습니다.



특성	조건	대표값	단위	시험방법
전기적 특성				
Dielectric Constant	@ 1MHz	3.20 ± 0.05		IPC-650 2.5.5.3
Dissipation Factor	@ 10 GHz	0.0030		IPC-650 2.5.5.5.1(Modified)
Volume Resistivity		10 ⁷	Mohm-cm	IPC-650 2.5.17.1
Surface Resistivity		10 ⁷	Mohm	IPC-650 2.5.17.1
열 특성				
Thermal Conductivity	unclad	0.24	W/M*K	ASTM F 433
CTE (50-150°C)	X	9	ppm/°C	ASTM D 3386/TMA
	Y	12		
	Z	70		
기계적 특성				
Peel Strength	1 oz. copper	2.1 (12)	N/mm (lb/in)	IPC-650 2.4.8
Flexural Strength	MD	>276 (40,000)	N/mm ² (lb/in)	IPC-650 2.4.4
	CD	>241 (35,000)	N/mm ² (lb/in)	
화학적 /물리적 특성				
Arc Resistance		180	Seconds	IPC-650 2.5.1
UL-94 Flammability Rating		V-0		UL-94

표준 두께	
Inches	mm
0.0100	0.25
0.0200	0.51
0.0300	0.76
0.0600	1.52
0.1200	3.04

공급가능 시트 사이즈			
Inches	mm	Inches	mm
12 x 18	305 x 457	16 x 36	406 x 914
16 x 18	406 x 457	24 x 36	610 x 914
18 x 24	457 x 610	18 x 48	457 x 1,220

- * 제공된 모든 테스트 데이터는 대표적인 값이며, 제품 스펙값으로 사용할 수 없습니다. 중요 스펙 공차에 대한 검토는 회사 담당자에게 직접 문의하십시오.
- * 표준 패널 규격은 18inch x 24inch (457 mm x 610 mm) 입니다.
- * 추가적인 두께, 기타 사이즈 및 동박구조에 대해서는 AGC에 문의하십시오.

